

平成 25 年
第 2 回 定 時 総 会 資 料

平成 25 年 5 月 24 日

一般社団法人エレクトロニクス実装学会

第 2 回 定 時 総 会 次 第

1. 日 時 平成 25 年 5 月 24 日 (金) 14 : 30 ~ 15 : 40
2. 会 場 回路会館 地下会議室
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 (TEL: 03-5310-2010)
(<http://www.e-jisso.jp/intro/intro07.html>)
3. 議 事

- (1) 開 会
- (2) 会長挨拶
- (3) 配付資料の確認
- (4) 総会成立の確認
- (5) 議長就任
- (6) 議事録署名人の選任
- (7) 議案審議

- 第 1 号議案 平成 24 年度事業報告【報告議題】
- 第 2 号議案 平成 24 年度収支決算並びに監査報告【審議議題】
- 第 3 号議案 平成 25 年度事業計画【報告議題】
- 第 4 号議案 平成 25 年度収支予算【報告議題】
- 第 5 号議案 理事・監事選任【審議議題】
- (8) 来賓挨拶 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課

- (9) 閉 会

総 会 終 了 後 行 事

1. 表 彰 式 15 : 45 ~ 16 : 05
学会賞 功績賞、技術功労賞、論文賞、技術賞
2. 記念講演 16 : 10 ~ 17 : 20
(技術賞受賞講演)
「分子接合技術を応用したポリイミドフィルム上への直接メタライジングによる両面フレキシブルプリント配線板の開発と量産化」
八甫谷 明彦氏 (株式会社東芝)

「酸化銀粒子接合を用いた高温環境対応実装技術の開発」
保田 雄亮氏 (株式会社日立製作所)
3. 懇 親 会 17 : 40 ~ 19 : 00

第2回定時総会資料

目 次

第1号議案	平成24年度事業報告	
	平成24年度事業報告書	1
第2号議案	平成24年度収支決算並びに監査報告	
	貸借対照表	9
	損益計算書（正味財産増減計算書）	10
	財務諸表に対する注記	11
	公益目的支出計画実施報告書	12
	監査報告	13
	公益目的支出計画実施報告監査報告	14
	補足説明資料1（収支計算書）	15
	補足説明資料2（事業別正味増減計算書）	16
	補足説明資料3（財産目録）	17
第3号議案	平成25年度事業計画	
	平成25年度事業計画書	18
第4号議案	平成25年度収支予算	
	平成25年度収支予算書	22
第5号議案	理事・監事選任	
	理事・監事候補者（案）	23

平成24年度事業報告書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

1. 全般

- (1)平成24年4月1日付けで本学会は一般社団法人へ移行した。
- (2)大会事業については、例年通り、国際会議ICEP、マイクロエレクトロニクスシンポジウム、講演大会を開催し最新の実装技術に関する情報交換の場を提供した。特に今期は、国際会議ICEP 2012についてはIAAC(IMAPS All Asia Conference)と併催し、当学会の国際的プレゼンスを高めた。講演大会については、震災復興に協力するために初めて東北地方（東北大学）で開催した。
- (3)技術調査事業については、学会活動の活性化と財政状況に適した組織で運営できる技術委員会・研究会の運営体制とすること、新規分野についての横断的研究会活動ができる組織とすることを目指して研究会組織の見直し・再編を行った。電子部品と先進実装の研究会の統合、官能検査自動化研究会の新設を行った。
- (4)展示会事業については、JPCAShow/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーの同時開催展示会において、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザを企画・運営するとともに、新たにベンチャー企業向けのeX-techを設け、展示会への来客の増員に寄与するとともに産学共同の情報交流の場を提供した。
- (5)教育事業については、教育講座および教育セミナーを実施し、実装技術の普及と技術者の育成に貢献した。
- (6)会誌発行事業については、学会誌および英文論文誌を発行し、実装技術の普及に貢献した。将来の完全電子化に向けて、紙ベースの学会誌発行と並行して、電子閲覧サービスを開始した。学会誌への投稿については、掲載までの期間短縮と業務の合理化を狙いに、JST(科学技術振興機構)のシステムを利用した電子投稿を開始した。
- (7)国際事業については、ICEP開催に係るIEEE CPMTおよびIMAPSとの関係を明確にするため、MOU (Memorandum of Understanding：了解覚書)を締結し、ICEPは、JIEPが主催、IEEE CPMT JapanとIMAPSは共催で開催することを明確にした。
- (8)支部事業については、関西支部では、例年の活動に加え、関西ワークショップおよび工場見学付講演会（ぷらっと関西）をリニューアルして活性化し、九州支部ではバイオメカニクスセンターと共同研究会を開催し、地域活動を積極的に展開した。
- (9)表彰事業については、例年どおり、実装分野の研究および技術分野での功績や学会活動の発展に貢献した方々を表彰した。今期から技術功労賞については、対象範囲を各事業委員会や技術委員会活動に貢献した方にも広げ表彰した。

2. 学会運営体制

- (1)一般社団法人への移行
一般社団法人移行を機に、全規程類38件を見直し、新規程として制定した。
- (2)学会活動の活性化対策
前年度に引き続き、新任役員の所信表明を学会誌に掲載するなど、学会活動をより公開・広報することに努めた。また会員のニーズや学会活動の新規分野への展開を容易にするための対応として、技術委員会－研究会体制の見直しを実施した。
- (3)Web学会ホームページの機能拡充
学会誌および英文論文誌の電子閲覧サービス開始とともに、Web学会ホームページをリニューアルした。さらに公開研究会の参加申込を簡易化し、担当委員の業務軽減のため、新たに、Web受付システムを導入した。
- (4)学会の運営体制
事務局については、職員の定年などによる退職に対して新規採用して、業務が円滑に継続できる

ような体制とした。財務対策については、永続的かつ健全な運営ができるように、事務局体制を含めた対策の検討を継続した。

3. 大会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「国際会議 ICEP 2012」（組織委員長 折井靖光氏 日本アイ・ビー・エム）

2012. 4. 17～20、東京ビッグサイトにて、IEEE CPMT Japan、IMAPS と共催で「国際会議 ICEP 2012」を開催した。今回は、IMAPS 主催の IAAC (IMAPS All Asia Conference) (今回が第1回) とジョイントして、ICEP-IAAC として開催した。海外 66 件 (Keynote 3 件含む) を含む総計 137 件の口頭発表、24 件のポスター発表があった。発表者も含めた参加者は 355 名 (内、海外 85 名)。

(2) 「第22回秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム」（組織委員長 近藤和夫教授 大阪府立大学）

2012. 9. 12～13、大阪府立大学 中百舌鳥キャンパスにて開催した。講演 76 件 (招待講演、依頼講演、ものづくりセッション含む) の発表があった。今回から、大学研究室紹介コーナーを設けてポスター掲示を行った。また、「電子デバイス実装の信頼性評価に関する研究—これまでの研究を振り返って—」(宮崎則幸教授 京都大学) と「エレクトロニクス業界の分析・現状と予測」(山本美継氏 BNPパリバ証券) の招待講演を行った。参加者は 311 名。

(3) 「2012 ワークショップ」（実行委員長 滝澤稔氏 東芝）

「サステイナブル社会実現に向けた実装技術の貢献～オリジナル技術で新価値創造・低コスト化に挑む!～」をテーマに、ラフォーレ修善寺にて、2012. 10. 18～19 で開催した。特別講演「無線機器の進展と電波防護評価」(大西輝夫氏 NTTドコモ) 及び、ナイトセッション「完全制御型植物工場」(松島巧氏 エスペック) を実施した。発表 35 件 (含むポスター含む)、参加者は 63 名。

(4) 「第27回春季講演大会」（講演大会委員長 小柳光正教授 東北大学）

「東北を実装技術のニューフロンティアへ!」と題して、東北地方の皆様の震災からの復興への願いを込め、東北大学 川内北キャンパスで開催 (2013. 3. 13～15) した。特別講演は「日本のモノづくり革命—歴史的転換点に立って—」(東レ 田中千秋氏)、「体内植込み型補助人工心臓「EVAHEART」の開発」(サンメディカル技術研究所 山崎俊一氏) の 2 件。講演発表は、ドリームチッププロジェクトの最終成果報告やプリントブルデバイス実装技術及び部品内蔵基板技術などの特別企画など、207 件 (ポスター 24 件、ものづくりセッション 28 件、チュートリアル 6 件含む) であった。ポスターセッションでは、若年層の学会参加を導くために、高等専門学校生に無料で発表する機会を設け 6 件の発表があった。参加者は 480 名。

4. 展示会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「JPCA Show/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーとの共同展示会」

2012. 6. 13～15 東京ビッグサイトで開催した上記 4 展示会において、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、新たにベンチャー、小企業向けの新企画として eX-tech を実施した。最先端実装技術シンポジウムは 12 セッション 34 講演を実施し、聴講者は延べ 448 名だった。アカデミックプラザは 38 件の発表があり聴講者は延べ 950 名。また 4 件のアカデミックプラザ賞を授与した。新企画の eX-tech には 18 社の出展があった。

(2) 「セミコン・ジャパン 2012 への展示・セミナー」

2012. 12. 5～7 幕張メッセにて開催したセミコン・ジャパン 2012 に、当学会活動を紹介するパネル (34 枚) を展示するとともに実装技術セミナー (無料) を実施した。ブース来場者は延べ 150～200 名、セミナー聴講者は立ち見も含め約 150 名。

5. 技術調査事業活動（定款第4条第2号関係）

(1) 技術委員会の活動

前年に引き続き、13 の技術委員会を組織し、実装技術分野の技術動向を調査し、技術展望などに

ついて、学会誌1月号に掲載した。また大会行事や最先端実装技術シンポジウムなどへの支援を行った。

(2) 研究会の活動

前年に引き続き、各技術委員会の傘下に合計23の研究会を組織し、具体的な個々の実装技術テーマについて、調査活動を行い委員相互の情報交換を行った。技術委員会と研究会の組織階層の在り方について議論を進め、以下の研究会組織の見直しを行った。

- ・電子部品実装技術委員会の2研究会を統合し「先進実装・電子部品研究会」とするとともに、運営委員会直轄の「プリントブルデバイス実装研究会」を当該技術委員会に所属させることとした。
- ・「環境配慮設計技術研究会」を解散し、新たに「環境と実装研究会」を新設した。
- ・新たに「官能検査自動化研究会」を設立し、技術運営委員会が直接統括することとした。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果については、公開研究会や学会誌などで広く公開した。開催した公開研究会等は以下のとおり。

担当研究会等	開催日	会場	参加人数	概要
機能性ハイブリッド研究会 (1)	12/12	回路会館	40	情報機器向け材料に関する講演5件
〃 (2)	2/12	回路会館	10	材料シミュレーションに関する講演2件
システム実装-CAD/CAE (1)	6/12	回路会館	14	「EMC設計技術」をテーマに、EMC関連基礎チュートリアル、グラウンド設計の課題の講演3件
〃 (2)	11/27	回路会館	41	「回路・実装設計におけるグラウンドとEMC」(平衡/不平衡伝送線路と放射)をテーマに講演5件
電磁特性技術委員会 (1)	7/19-20	機械振興会館	50	電子情報通信学会 EMCJ 研究会との協賛研究会 若手研究会 (7/19) と一般研究会 (7/20)
〃 (2) (サマーセミナー)	8/30	芝浦工業大学	115	「高品質な高速差動信号伝送を実現する技術！高速信号伝送と LSI 安定動作のためのプリント基板設計」のテーマで講演5件
低ノイズ研究会 (1)～(8)	6月より 11月	回路会館	59	設計技術実践講座 EMC 講座(8回)
超高速・高周波エレクトロニクス実装研究会(1)	5/18	回路会館	25	「基板表面及び界面比導電率の測定」など講演4件
〃 (2)	7/27	マホロバマイ ンズ三浦	28	「携帯機器の電磁干渉の視覚化実例」など講演6件、製品技術紹介1件
〃 (3)	11/2	回路会館	18	「VLSIの高速信号伝送技術」など講演5件
〃 (4)	2/15	回路会館	55	「10Gbps バックプレーン伝送」など講演5件、製品技術紹介1件
マイクロナノアプリケーション研究会 (1)	7/23	回路会館	75	次世代インターポーザ技術動向に関する講演4件
〃 (2)	9/24	回路会館	78	プリントドエレクトロニクスの最新技術動向に関する講演5件
〃 (3)	12/11	回路会館	59	プリントドエレクトロニクスの最新技術動向に関する講演4件
先進実装技術研究会 (1)	6/21	横浜国立大学	53	環境実装、耐熱性樹脂の高機能化、3次元実装技術などの YJC 講演会に協賛
〃 (2)	9/5	回路会館	71	「半導体 3D インテグレーション技術の最新動向」のテーマで講演5件

〃 (3)	11/16	溶接会館	85	「第2世代Pbフリーはんだ微細接合及びその信頼性」をテーマとする溶接協会講演会に協賛
〃 (4)	12/13	横浜国立大学	58	「パワーエレクトロニクス実装技術最前線」をテーマとするYJC講演会に協賛
ボードテスト技術研究会	11/30	回路会館	18	「“見えない、触れない”基板の検査」のテーマで講演5件
OPT研究会(1)	7/10	回路会館	29	「空間光変調器を利用した光モジュール技術の最新動向」のテーマで講演4件
〃 (2)	10/9	回路会館	40	「太陽電池と光実装技術」のテーマで講演3件
〃 (3)	1/24	回路会館	30	「光技術の医療・生体センシング領域への展開」のテーマで講演6件
環境配慮設計技術研究会(1)	7/26	回路会館	29	「環境配慮設計と先端サーマルテクノロジー」のテーマで講演4件
〃 (2)	1/23	回路会館	50	「今、求められる熱マネジメント最前線！」のテーマで講演5件
システムインテグレーション実装技術研究会	11/6	回路会館	60	「システム思考で変わる実装技術トレンドー実用化近づく三次元集積化デバイスへの最新対応技術と動向ー」のテーマで講演6件
e-テキスタイル研究会(1)	11/12	マイクロマシンセンター	35	「今後のデジタルヘルスの動向」など講演4件
〃 (2)	2/15	京都工芸繊維大学	55	「ナノ・マイクロ流体デバイスのための超高感度センシング技術の基礎研究」など講演3件
標準化状況調査研究会(1)	7/27	マホロバマイズ三浦	28	「プリントドエレクトロニクスの国際標準化動向」など講演3件
〃 (2)	2/28	回路会館	32	「実装評価技術の国際標準化」など講演4件
EPADs技術調査研究会(1)	7/5	回路会館	81	「LSI内蔵基盤/パッケージの最新動向」のテーマで講演5件
〃 (2)	9/7	回路会館	113	「部品内蔵基板を支える実装材料・技術」のテーマで講演5件
〃 (3)	11/22	回路会館	108	「海外における部品内蔵基板の最新技術動向」のテーマで講演5件
〃 (4)	2/14	回路会館	84	「部品内蔵基板の最新技術動向」のテーマで講演5件
サーマルマネジメント研究会(1)	6/6	回路会館	57	「自然空冷機器の熱設計」など講演2件
〃 (2)	1/28	大阪大学	36	「定常法による基板材料の熱伝導率評価法と測定結果に及ぼす系内の熱移動現象」など講演3件
プリントブルデバイス実装研究会	11/21	東京大学	80	「医療ITとプリントドエレクトロニクス実装」のテーマで講演5件

6. 教育事業活動（定款第4条第3号関係）

(1) 教育講座の実施

①PWB製造・初級コース（2012.6.26～27 回路会館）

新入社員、営業担当者向けに、広い技術分野にまたがるプリント配線板について、基礎知識の修得を目標とした初級コースの教育講座を実施した。受講者は49名。

②第12回実装技術総合講座（2012.10.29～30 回路会館）

企業で実装技術に関わる中堅技術者や、これから実装技術に関わる異分野の技術者を対象として、実装技術総合講座を実施した。受講者は41名。

(2) 教育セミナーの実施

①第56回定例セミナー（2012.10.24 回路会館）

基調講演「エレクトロニクス機器を支える最先端めっき技術の動向と展望」（甲南大学・縄舟秀美教授）ほか一般講演4件を実施した。受講者は41名。

②第57回定例セミナー（2013.2.5 回路会館）

基調講演「3次元実装構造の最新技術動向」（長野実装フォーラム・傳田精一氏）ほか一般講演4件を実施した。受講者は63名。

7. 会誌発行事業活動（定款第4条第4号関係）

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を7回発行した。研究開発活動の成果として研究論文、総合論文、速報論文、解説等を掲載し、実装技術に関する最新情報を会員に提供した。編集委員会企画特集号（9月号）では「極限の技術を求めて！」をテーマに論文6件を掲載した。また、理事会や各事業委員会の活動状況についても広報した。

(2) 英文論文誌の発行

論文数17件を掲載した英文論文誌 Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.5を2012年12月に発行した。平成25年度からは、費用圧縮のため、基本的に冊子を印刷せず電子閲覧のみするとともに、効果的に海外にアピールするために英文ホームページから一般閲覧できるようにする方針を決めた。

(3) 学会誌の電子投稿システム

投稿から掲載までの期間短縮と編集業務の合理化を狙いに、JST(科学技術振興機構)のシステムを利用した電子投稿を平成25年3月から開始した。

(4) 電子閲覧システム（電子ジャーナル化）

会員の会誌閲覧の利便性向上のために、学会誌、英文論文誌について、Webホームページの「会員のページ」から発行と同時に閲覧できる電子閲覧サービスを2012年7月から開始した。

(5) 韓国語翻訳転載

学会誌の解説記事および論文のうち46件が、雑誌「表面実装技術」（韓国 尖端社 発行）に翻訳転載され、国際普及が進められた。

8. 国際事業活動（定款第4条第5号関係）

(1) ICEPの運営体制の明確化

ICEPについて、IEEE CPMT JapanおよびIMAPSとMOU(Memorandum of Understanding:了解覚書)を締結し、主催を当学会とし、共催をIEEE CPMT JapanとIMAPSとすることを明確にした。

(2) IMAPSとの連携活動

①IMAPSのAffiliate会員受付代行サービスを継続した。会員登録は27名。

②IMAPS ALC(Asia Liaison Committee)からの要請に応じ、ICEP2012に合わせて開催したIAAC(IMAPS All Asia Conference)を支援した。

(3) IEEE CPMT Societyとの連携活動

当学会の国際的なプレゼンスを高めるとともに会員に国際交流活動の場を提供することを狙いとして、IEEE CPMT Society との連携活動を継続した。IEEE CPMT Japan と ICEP2012 を共催し、優秀論文を表彰するなどのコラボレーションを行った。

9. 支部事業活動(定款第4条第6号関係)

(1) 関西支部

① 第16回若手研究会 세미나 (2012.6.27 大阪府立大学中之島サテライト)

「エレクトロニクスを支えるめっき技術-基礎から将来展望まで-」をテーマとして3講義を行った。めっきの基礎から、めっきの応用における具体的な問題と対処法、新しい技術展開・今後の展望について講義が行われた。受講者は39名。

② 関西ワークショップ (2012.7.12-13 ラフォーレ琵琶湖)

ナイトセッション(1日目)では、「日本実装業界の将来像」とのテーマで、講師5名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。2日目は特別講演「世界が動き出したプリント・エレクトロニクス」(大阪大学 菅沼克昭教授)の後、3Dインテグレーションなど10テーマ分野で30件のポスタ発表が行われた。参加者は103名。

③ 「ぶらっと関西」 (2012.11.16 京都大学吉田キャンパス)

従来の工場見学会を、名称を変え、無理のない運営方法で再開した。再開京都大学「次世代低炭素ナノデバイス創製ハブ」見学した。参加者は30名。

④ 第17回若手研究会 세미나 (2013.1.22 大阪府立大学中之島サテライト)

「エレクトロニクス実装技術 基礎から将来展望まで」というテーマで、実装技術の基礎となる要素技術の原理解説及び半導体パッケージ技術の動向、配線板の基礎、超高密度実装技術の基礎から今後の展開まで広い範囲の講義がウェイスティー・福岡義孝氏より行われた。受講者は35名。

⑤ 第9回技術講演会 (2013.2.19 大阪大学中之島センタ)

テーマを「パワーエレクトロニクス実装における要素技術の最新動向」として総括から各種要素技術について、各分野の著名な4名が講演した。参加者は70名。

(2) 九州支部

バイオメカニクス関連との異分野における研究交流を目的とし「九州大学バイオニクス研究会&エレクトロニクス実装学会九州支部合同研究会」を九州大学伊都キャンパス稲盛記念館にて、3月8~9日に開催した。参加者は60人で、招待講演、一般講演、懇親会にて産官学の研究交流を行った。

10. 表彰事業活動(定款第4条第6号関係)

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーション向上のために以下の表彰を行った。

(1) 学会賞(1件)

「ビルドアップ基板技術の開発に対する貢献」 塚田裕(立命館大学)

(2) 功績賞(1件)

「信頼性解析技術の指導・普及活動に対する功績」 津久井勤(リサーチラボ・ツクイ)

(3) 技術賞(2件)

① 「分子接合技術を応用したポリイミドフィルム上への直接メタライジングによる両面フレキシブルプリント配線板の開発と量産化」

八甫谷明彦(東芝)、宮脇学、道脇茂、瀧井秀吉(メイコー)、工藤孝廣、森邦夫(いおう化学研究所)

② 「酸化銀粒子接合を用いた高温環境対応実装技術の開発」

保田雄亮、床尾尚也、井出英一、小池義彦、守田俊章(日立製作所)

(4) 論文賞(2件)

① 「表面間力の定量的評価に基づくMEMSスイッチのステイクション防止膜の検討」

山下崇博、須賀唯知(東大)、伊藤寿浩(産総研)

②「エレクトロマイグレーション計算と放射光 X 線 CT 観察によるフリップチップはんだ接続部のボイド成長解析」

谷江尚史、藤原伸一、新谷寛、春別府佑（日立製作所）、千綿伸彦、藤吉優（日立金属）

(5) 技術功労賞（4 件）

①田畑晴夫（大阪大学）“永年にわたり、展示会事業及び教育事業等の学会活動に携わってきた功労”

②安食弘二 “永年にわたり、会誌発行事業及び技術調査事業等の学会活動に携わってきた功労”

③福岡義孝（ウェイスティアー）：“永年にわたり、国際事業及び教育事業等の学会活動に携わってきた功労”

④谷貞宏（ST-Lab）“永年にわたり、回路・実装設計技術委員会等の活動に携わってきた功労”

(6) 春季講演大会表彰

第 26 回講演大会【講演大会優秀賞】（5 件）

①9C-18 「酸化銅系材料を用いた高温環境対応鉛及び貴金属フリー接合法」

守田俊章、保田雄亮、（日立製作所）小林芳男（茨城大学）

②8A-02 「回路基材としての液晶ポリマーフィルムの誘電特性改善」小野寺稔、砂本辰也（クラレ）、小林禎夫（サムテック）

③9D-09 「パターンめっき・転写法（PPT プロセス）基板 PKG の開発」直之進（日立化成工業）

④8A-19 「電源供給回路共振への臨界減衰適用による IC/LSI の EMC 性能改善」

五百旗頭健吾、矢野佑典、豊田啓孝（岡山大学）

⑤8C-15 「高性能・高信頼性ダメージレスパッケージング技術」中野高宏、下石坂望、山口栄次、迫田英樹、定別当裕康、尾倉淳（コネクテックジャパン）

第 26 回講演大会【研究奨励賞】（5 件）

①9C-02 「3 次元フォトマスクを用いたマスク転写自己形成技術による光プラグの試作」

松澤雄介（東海大学）

②8A-11 「シールド平衡ケーブルのコネクタ接地とノイズ耐性」 渡邊陽介（三菱電機）

③9A-13 「低背相変化冷却器を利用した薄型 I C T 機器の冷却電力削減」 松永有仁（日本電気）

④7B-04 「Au スパッタ膜を介した表面活性化接合を用いた垂直配向カーボンナノチューブと Au 薄膜の接合と転写」 藤野真久（東京大学）

⑤7C-05 「カーボンナノチューブを応用した二次元ひずみ分布検出センサ」 鈴木悠介（東北大学）

第 27 回講演大会【ポスタワード】（3 件）

①13PD-02：「銅のウェットエッチングにおける界面活性剤の効果」 畑中亮英 1、関下明日香 1、久保田賢治 2、3、松本克才 1（1：八戸工業高専、2：宇都宮大学、3：三菱マテリアル）

②13PD-09：「IC チップレベルのノイズ結合評価を目的とした 3D 近傍磁界計測装置」 重田洋二郎、室賀翔、荒井薫、ドゥンガナサンディープ、奥田亮介、遠藤恭、山口正洋（東北大学）

③13PD-12：周波数特性を持つターゲットインピーダンスに関する考察

山口冬生、鳩貝裕介、須藤俊夫（芝浦工業大学）

(7) 秋季大会 MES2012 表彰

【ベストペーパー賞】（4 件）

①1A2-4 「クラッド材を用いた高温 Pb フリー接合材」山口拓人 1、池田靖 1、秦昌平 1、小田祐一 2、黒木一真 2（1 日立製作所、2 日立電線）

②1C1-3「表面張力を利用した Si 薄ダイのセルフアライメントにおけるロバスト性評価」廣島 満 1、有田潔 1、土師宏 1、Oberhofer Bernhard 2、Landesberger Christof 3、Scherbaum Sabine 3、Weber Josef 3、Bock Karlheinz 3（1 パナソニック ファクトリーソリューションズ、2 Panasonic Factory Solutions Europe GmbH、3 Fraunhofer EMFT）

③XX-N「導電接着剤における電極間導電経路の 3 次元可視化」荒尾修、新帯亮、杉浦昭夫（デンソー）

④2C4-5 「人体通信用電界センサ “HMR” による微小信号測定実験」加藤康男、水澤純一、

佐久田博司（青山学院大学）

【研究奨励賞】(5件)

- ①1A2-2「Agワイヤの接合信頼性」 安徳優希(田中電子工業)
- ②2A1-4「ポリイミドフィルム上への直接メタライジング法による両面フレキシブルプリント配線板の開発」道脇茂(マイコー)
- ③2B3-3「電解銅めっきにおけるPRパルス電流制御による直径4 μ mビア完全充填」
林太郎(大阪府立大学大学院)
- ④2B4-4「Sn-Bi共晶はんだを用いた微細はんだ接合部のエレクトロマイグレーション挙動に及ぼすバリア層の影響」酒井徹(大阪大学大学院)
- ⑤2C1-2「有限要素法を用いた結晶シリコン太陽電池の劣化予測」山口修平(横浜国立大学)

(8) ICEP2012 表彰

【ベストペーパー賞】(4件)

- ①TA2-3"Thermal Performance of 3D IC Package with Embedded TSVs" Ra-Min Tain, Ming-Ji Dai, Yu-Lin Chao, Sheng-Liang Li, Heng-Chieh Chien, Sheng-Tsai Wu, Wei Li and Wei-Chung Lo (Industrial Technology Research Institute / Taiwan)
- ②FA1-2"Silicon Cavity Encapsulation with TSV Electrode for Pseudo-SoC Microwave Application" Toshihiko Nagano, Kazuhide Abe, Hiroshi Yamada and Kazuhiko Itaya (Toshiba / Japan)
- ③FB1-3"Analysis on Design and Mechanical Stress of 2.5D Package Interposers" Takashi Hisada, Toyohiro Aoki, Junko Asai and Yasuharu Yamada (IBM Japan / Japan)
- ④FC1-3"Effect of the crystallinity of electroplated copper thin films on their mechanical and electrical reliability" Naokazu Murata, N. Saito, K. Suzuki and H. Miura (Tohoku University / Japan)

【ポスターアワード】(2件)

- ①Poster-06:"The Bonding of InP/Si at Room Temperature" Takashi Matsumae(The University of Tokyo / Japan)他
- ②Poster-23:"Block copolymer porous films for the enhancement of thermoelectric properties" Kuniyoshi Kato (LINTEC/ Japan)他

11. その他の活動 (定款第4条第5号関係)

(1) 関連学協会の各種事業との協力活動

電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会、溶接協会、表面技術協会など24学協会、37件の講演大会などの行事について協賛した。一方、秋季大会MESおよび春季講演大会では22学協会から協賛を受けるなど、相互に交流を深めた。また、支部レベルでは、関西にある他の学協会支部と相互に協賛を行い活動の活性化に寄与した。

12. 平成25年3月31日現在の会員数

正会員	2,428名	(前年同期比 95名減)
学生会員	193名	(前年同期比 16名減)
賛助会員	161社	(前年同期比 6社減)
賛助会員口数	322口	(前年同期比 6口減)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	158,892	77,764	81,128	
普通預金	11,608,570	13,169,587	△ 1,561,017	
郵便振替	4,213,882	5,602,786	△ 1,388,904	
郵便貯金	1,657,268	2,004,579	△ 347,311	
定期預金	11,526,208	11,500,000	26,208	
未収金	400,000	148,000	252,000	
仮払金	6,815,462	6,048,790	766,672	
前払金	619,342	730,346	△ 111,004	
流動資産合計	36,999,624	39,281,852	△ 2,282,228	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	13,669,212	27,695,420	△ 14,026,208	退職金の支払と積立
記念行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0	
国際交流引当資産	18,500,000	18,500,000	0	経1の実施事業資産(定期預金18,500,000円) 経3の実施事業資産(定期預金6,000,000円) 経5の実施事業資産(定期預金10,500,000円)
学術振興引当資産	16,500,000	24,500,000	△ 8,000,000	
情報ネットワーク構築引当資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
特定資産合計	59,669,212	82,695,420	△ 23,026,208	
(2) その他固定資産				
器具備品	12,127	26,357	△ 14,230	
電話加入権	438,984	438,984	0	
ソフトウェア	231,434	48,160	183,274	会計ソフトのバージョンアップ
保証金	15,000,000	15,000,000	0	
その他固定資産合計	15,682,545	15,513,501	169,044	
固定資産合計	75,351,757	98,208,921	△ 22,857,164	
資産合計	112,351,381	137,490,773	△ 25,139,392	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,090,120	1,023,953	66,167	
前受金	12,938,590	11,952,295	986,295	
預り金	1,015,187	595,829	419,358	
仮受金	17,000	18,000	△ 1,000	
流動負債合計	15,060,897	13,590,077	1,470,820	
2 固定負債				
退職給付引当金	13,669,212	27,695,420	△ 14,026,208	
固定負債合計	13,669,212	27,695,420	△ 14,026,208	
負債の部合計	28,730,109	41,285,497	△ 12,555,388	
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	83,621,272 (46,000,000)	96,205,276 (55,000,000)	△ 12,584,004 (△9,000,000)	
正味財産合計	83,621,272	96,205,276	△ 12,584,004	
負債及び正味財産合計	112,351,381	137,490,773	△ 25,139,392	

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

（単価：円）

科 目	今年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	248,000	224,000	24,000
受取会費	48,805,500	49,584,895	△ 779,395
事業収益	44,597,153	41,125,091	3,472,062
参加費	34,905,433	33,342,245	1,563,188
資料販売	4,306,006	2,555,934	1,750,072
広告掲載料	3,547,425	3,267,930	279,495
情報使用料	286,851	680,684	△ 393,833
会誌掲載料	818,750	344,000	474,750
その他	732,688	934,298	△ 201,610
雑収益	110,170	53,869	56,301
経常収益取計	93,760,823	90,987,855	2,772,968
(2) 経常費用			
事業費	83,692,093	76,973,046	6,719,047
給料手当て	24,312,598	24,843,366	△ 530,768
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0
福利厚生費	3,557,671	3,662,463	△ 104,792
会議費	14,445,549	10,783,183	3,662,366
旅費交通費	6,970,496	5,983,242	987,254
通信運搬費	2,053,054	2,270,157	△ 217,103
減価償却費	46,478	45,770	708
消耗什器備品費	0	175,927	△ 175,927
消耗品費	415,556	521,719	△ 106,163
修繕費	930,275	547,017	383,258
印刷製本費	14,822,207	12,519,642	2,302,565
光熱水道費	124,563	145,107	△ 20,544
貸貸料	7,501,540	6,075,903	1,425,637
諸謝金	4,531,672	4,665,825	△ 134,153
租税公課	394,214	769,200	△ 374,986
支払負担金	58,302	80,600	△ 22,298
支払助成金	1,078,532	1,125,655	△ 47,123
委託費	0	368,460	△ 368,460
雑費	949,386	889,810	59,576
管理費	22,652,734	23,532,985	△ 880,251
役員報酬	0	0	0
給料手当て	11,068,624	11,266,390	△ 197,766
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0
福利厚生費	1,958,257	1,851,281	106,976
会議費	339,782	344,506	△ 4,724
旅費交通費	704,380	869,580	△ 165,200
通信運搬費	491,798	689,382	△ 197,584
減価償却費	46,478	45,770	708
消耗什器備品費	0	169,676	△ 169,676
消耗品費	415,556	521,726	△ 106,164
修繕費	930,276	547,019	383,257
印刷製本費	350,622	234,662	115,960
光熱水道費	124,563	145,107	△ 20,544
貸貸料	3,219,300	3,171,686	47,614
諸謝金	667,275	678,810	△ 11,535
租税公課	394,220	769,200	△ 374,980
委託費	0	368,460	△ 368,460
雑費	441,597	359,730	81,867
経常費用計	106,344,827	100,506,031	5,838,796
評価損益等調整前当期経常増益額	△ 12,584,004	△ 9,518,176	△ 3,065,828
当期経常増減額	△ 12,584,004	△ 9,518,176	△ 3,065,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,584,004	△ 9,518,176	△ 3,065,828
一般正味財産期首残高	96,205,276	105,723,452	△ 9,518,176
一般正味財産期末残高	83,621,272	96,205,276	△ 12,584,004
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,621,272	96,205,276	△ 12,584,004

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている。
無形固定資産……定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	27,695,420	3,000,000	17,026,208	13,669,212
記念行事引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
国際交流引当資産	18,500,000	0	0	18,500,000
学術振興引当資産	24,500,000	0	8,000,000	16,500,000
情報ネットワーク構築引当資産	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000
合計	82,695,420	3,000,000	26,026,208	59,669,212

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	13,669,212	-	(0)	(13,669,212)
記念行事引当資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
国際交流引当資産	18,500,000	(0)	(18,500,000)	-
学術振興引当資産	16,500,000	(0)	(16,500,000)	-
情報ネットワーク構築引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
合計	59,669,212	(0)	(46,000,000)	(13,669,212)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,930,530	1,918,403	12,127
合計	1,930,530	1,918,403	12,127

公益目的支出計画実施報告書

【平成24年度(2012/4/1から2013/3/31まで)の概要】

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

(単位 円)

1. 公益目的財産額	96,205,276
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	39,094,940
(1) 前年事業年度末日の公益目的収支差額	0
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	83,692,093
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	44,597,153
3. 当該事業年度末日の公益目的財産額	57,110,336
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要および理由 注	
計画に記載した見込額と異なっている概要(及び主な理由)は次の通り。	
継1 収支差額は見込3,718,189円に対して実績6,560,831円で差引2,842,642円の増(参加費収入減少のため)	
継2 収支差額は見込4,354,577円に対して実績4,769,975円で差引415,398円の増(旅費交通費増加のため)	
継3 収支差額は見込10,373,613円に対して実績10,089,168円で差引284,445円の減(参加費収入増加のため)	
継4 収支差額は見込991,204円に対して実績-371,594円で差引1,362,798円の減(参加費収入増加のため)	
継5 収支差額は見込14,649,154円に対して実績13,118,390円で差引1,530,764円の減(印刷製本費減少のため)	
継6 収支差額は見込1,667,831円に対して実績1,393,920円で差引273,911円の減(支払分担金減少のため)	
継7 収支差額は見込1,493,373円に対して実績1,042,890円で差引450,483円の減(参加費収入増加のため)	
継8 収支差額は見込2,737,831円に対して実績2,491,360円で差引246,471円の減(支払助成金減少のため)	

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1) 計画上の完了見込み	21015/3/31
	(2) (1)より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額			96,205,276	96,205,276	96,205,276
公益目的収支差額			39,985,772	39,094,940	79,971,544
公益目的支出の額			81,295,772	83,692,093	81,295,772
実施事業収入の額			41,310,000	44,597,153	41,310,000
公益目的財産残額			56,219,504	57,110,336	16,233,732

注: 前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載ください

継続事業1	大会事業
継続事業2	展示会事業
継続事業3	技術調査事業
継続事業4	教育事業
継続事業5	会誌発行事業
継続事業6	国際事業
継続事業7	支部事業
継続事業8	表彰事業

一般社団法人エレクトロニクス実装学会
会長 嶋田 勇三 殿


平成 25 年 4 月 22 日


私共監事は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの社団法人エレクトロニクス実装学会の会計監査、並びに理事の会務の執行を監査しましたのでご報告します。

監査の結果

- (1) 会計監査は本会収支計算書、財務目録および貸借対照表に記載されている事項について行った結果、法令及び定款に従い当法人の財産および収支の状況を正しく示していると認める。
- (2) 理事の会務執行に関する不正の行為もしくは法令、定款に違反する重大な事実は認められない。

以上報告します。

監事 中 祖 昭 士 

監事 瀧 谷 昇 

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
会長 嶋田 勇三 殿

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの公益目的支出計画実施報告書に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。


2. 監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。


平成25年4月22日

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

監事

中 祖 昭 士 

監事

瀧 谷 昇 

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

(単価:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
(1) 継続(公益)事業収入	44,250,000	44,597,153	△ 347,153	
大会等事業収入	24,200,000	20,604,243	3,595,757	大会以外の減収
展示会事業収入	80,000	0	80,000	
技術調査事業収入	6,350,000	10,454,060	△ 4,104,060	公開研究会等の増収
教育事業収入	4,700,000	4,285,620	414,380	新規講座の中止による減収
会誌発行事業収入	6,460,000	6,372,960	87,040	
国際事業収入	140,000	81,000	59,000	
支部事業収入	2,320,000	2,799,270	△ 479,270	関西WS等事業収入増
(2) 法人会計収入	49,090,000	49,163,670	△ 73,670	
① 会費収入	49,040,000	49,053,500	△ 13,500	
入会金収入	200,000	248,000	△ 48,000	
正会員会費収入	23,000,000	23,011,500	△ 11,500	
賛助会員会費収入	25,600,000	25,560,000	40,000	
学生会員会費収入	240,000	234,000	6,000	
② 雑収入	50,000	110,170	△ 60,170	
雑収入	50,000	110,170	△ 60,170	
事業活動収入計	93,340,000	93,760,823	△ 420,823	
2 事業活動支出				
(1) 継続(公益)事業費支出	77,500,000	82,145,615	△ 4,645,615	
大会事業費支出	15,180,000	16,215,662	△ 1,035,662	大会以外の費用増
展示会事業費支出	720,000	1,237,905	△ 517,905	展示会委員会等費用増
技術調査事業費支出	8,000,000	13,125,882	△ 5,125,882	公開研究会費用・旅費増
教育事業費支出	2,010,000	1,441,578	568,422	新規講座の中止による費用減
会誌発行事業費支出	12,990,000	12,427,212	562,788	会誌印刷費等費用削減
国際事業費支出	130,000	62,092	67,908	
支部事業費支出	2,870,000	2,782,540	87,460	
事業共通事務費	34,520,000	33,774,212	745,788	共通費用の節約
表彰事業支出	1,080,000	1,078,532	1,468	
(2) 法人会計支出	21,670,000	21,106,256	563,744	管理費全体は圧縮
事務人件費支出	11,000,000	11,068,624	△ 68,624	
福利厚生費支出	1,850,000	1,958,257	△ 108,257	保険料等の改訂による増額
会議費支出	300,000	339,782	△ 39,782	
通信運搬費支出	650,000	491,798	158,202	総会案内資料等通信費節約
什器備品費支出	170,000	0	170,000	新規購入無し
消耗品費支出	450,000	415,562	34,438	
印刷費支出	230,000	350,622	△ 120,622	イベント広告の印刷費増
光熱水道費支出	150,000	124,563	25,437	
旅費交通費支出	850,000	704,380	145,620	理事会等委員旅費の削減
賃借料支出	3,170,000	3,219,300	△ 49,300	
租税公課支出	770,000	394,220	375,780	
事務電子化経費支出	1,000,000	930,276	69,724	
謝礼金支出	680,000	667,275	12,725	
新公益法人制度対策費	70,000	84,128	△ 14,128	
雑費支出	330,000	357,469	△ 27,469	
事業活動支出計	99,170,000	103,251,871	△ 4,081,871	
事業活動収支差額	△ 5,830,000	△ 9,491,048	3,661,048	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	17,100,000	17,026,208	73,792	
学術振興特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
情報ネットワーク構築特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	26,100,000	26,026,208	73,792	
(2) 投資活動支出				
退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付支出	17,100,000	17,026,208	73,792	
ソフトウェア取得支出	0	262,000	△ 262,000	会計ソフトのバージョンアップ
投資活動支出計	20,100,000	20,288,208	△ 188,208	
投資活動収支差額	6,000,000	5,738,000	262,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	170,000	△ 3,753,048	3,923,048	
前期繰越収支差額	25,691,775	25,691,775	0	
次期繰越収支差額	25,861,775	21,938,727	3,923,048	

事業別正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

(単価:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の増益			
(1) 継続事業収益	44,597,153	41,125,091	3,472,062
大会事業収益	20,604,243	22,886,779	△ 2,282,536
展示会事業収益	0	65,250	△ 65,250
技術調査事業収益	10,454,060	6,914,934	3,539,126
教育事業収益	4,285,620	4,095,400	190,220
会誌発行事業収益	6,372,960	5,692,514	680,446
国際事業収益	81,000	144,000	△ 63,000
支部事業収益	2,799,270	1,326,214	1,473,056
(2) 法人会計収益			
① 受取会費	49,053,500	49,808,895	△ 755,395
入会金	248,000	224,000	24,000
正会員会費	23,011,500	23,396,895	△ 385,395
賛助会員会費	25,660,000	25,920,000	△ 360,000
学生会員会費	234,000	268,000	△ 34,000
② 収益	110,170	53,869	56,301
雑収入	110,170	53,869	56,301
法人会計と継続事業の収益総計	93,760,823	90,987,855	2,772,968

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の減益			
(1) 継続事業費	83,692,093	76,973,046	6,719,047
大会事業費	16,215,662	14,664,717	1,550,945
展示会事業費	1,237,905	738,781	499,124
技術調査事業費	13,125,882	8,400,941	4,724,941
教育事業費	1,441,578	1,516,720	△ 75,142
会誌発行事業費	12,427,212	12,432,911	△ 5,699
国際事業費	62,092	80,600	△ 18,508
支部事業費	2,782,540	1,411,067	1,371,473
表彰事業費	1,078,532	1,125,655	△ 47,123
事業共通事務費	35,320,690	36,601,654	△ 1,280,964
(2) 法人会計費用	22,652,734	23,532,985	△ 880,251
事務人件費	11,068,624	11,266,390	△ 197,766
福利厚生費	1,958,257	1,851,281	106,976
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0
会議費	339,782	344,506	△ 4,724
通信運搬費	491,798	689,382	△ 197,584
什器備品費	0	169,676	△ 169,676
消耗品費	415,562	521,726	△ 106,164
印刷費	350,622	234,662	115,960
光熱水道費	124,563	145,107	△ 20,544
旅費交通費	704,380	869,680	△ 165,200
賃借料	3,219,300	3,171,686	47,614
租税公課	394,220	769,200	△ 374,980
事務電子化経費	930,276	547,019	383,257
諸謝金	667,275	678,810	△ 11,535
公益法人制度対策費	84,128	368,460	△ 284,332
減価償却費	46,478	45,770	708
雑費	357,469	359,730	△ 2,261
当期の法人会計と継続事業の減益総計	106,344,827	100,506,031	5,838,796
正味財産の増減			
当期の法人会計と継続事業の正味財産増減総計	△ 12,584,004	△ 9,518,176	△ 3,065,828
公益目的財産の当期増減	△ 39,094,940		
公益目的正味財産期首残高	96,205,276		
公益目的正味財産期末残高	57,110,336		
当期法人会計財産の増減	26,510,936		
法人会計正味財産期首残高	0		
法人会計正味財産期末残高	26,510,936		
法人会計と公益目的財産の正味財産増減総計	△ 12,584,004	△ 9,518,176	△ 3,065,828
法人会計と公益目的の正味財産期首残高総計	96,205,276	105,723,452	△ 9,518,176
法人会計と公益目的の正味財産期末残高	83,621,272	96,205,276	△ 12,584,004

平成25年3月31日現在

一般社団法人エレクトロニクス実装学会

(単価：円)

科目		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	手許保管	158,892
普通預金 (1)	三菱東京UFJ銀行 西荻窪駅前支店	306,066
普通預金 (2)	みずほ銀行 西荻窪支店	438,967
普通預金 (3)	三井住友銀行 西荻窪支店	10,653,201
普通預金 (4)	りそな銀行 荻窪支店	210,336
郵便振替	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	4,213,882
通常貯金	ゆうちょ銀行杉並西荻北郵便局	1,657,268
定期預金 (1)	三井住友銀行 西荻窪支店	8,026,208
定期預金 (2)	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	2,000,000
定期預金 (3)	りそな銀行 荻窪支店	1,500,000
未収金 (1)	未収会費	200,000
未収金 (2)	その他	200,000
仮払金	関西支部他	6,815,462
前払金	展示会費用他	619,342
	流動資産合計	36,999,624
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	三井住友銀行 西荻窪支店	13,669,212
記念行事引当資産	ゆうちょ銀行 杉並西荻北郵便局	5,000,000
国際交流引当資産	みずほ銀行 西荻窪支店	18,500,000
学術振興引当資産	三菱東京UFJ銀行 西荻窪駅前支店	16,000,000
	りそな銀行 荻窪支店	500,000
情報ネットワーク構築引当資産	りそな銀行 荻窪支店	6,000,000
	特定資産合計	59,669,212
(2) その他固定資産		
器具備品	プロジェクター 他	12,127
電話加入権		438,984
ソフトウェア		231,434
保証金	(一社) 日本電子回路工業会	15,000,000
	その他固定資産合計	15,682,545
	固定資産合計	75,351,757
	資産合計	112,351,381
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険料 他	1,090,120
前受金	正会員年会費収入 他	12,938,590
預り金	源泉所得税	1,015,187
仮受金	会費その他	17,000
	流動負債合計	15,060,897
2 固定負債		
退職給付引当金		13,669,212
	固定負債合計	13,669,212
	負債合計	28,730,109
III 正味財産		
		83,621,272

平成25年度事業計画書

自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日

1. 全般

- (1) 本学会の運営の基本方針として次の項目に示す活動を推進する。
 - ① 世界をリードする実装技術のけん引役としての活動
 - ② 幅広い技術領域をカバーしていることを活かし展開
 - ③ 将来を担う若い実装技術者の育成と魅力ある活動の場の提供
- (2) 学会活動の活性化を図るために、会員増強活動を引き続き展開するとともに、会員主体の学会活動をより推進するために、学会運営の公平性と透明性の強化に努める。従来からの学会活動に加え、新しいアイデア、新しい概念、新しい考え方を注入して、イノベーションを起こした革新的な活動を推進する取組みに努める。
- (3) 技術調査事業については、引続き、学会の基盤活動である技術委員会および研究会の活動を強化・活性化するとともに必要に応じて組織の見直しを検討する。新規テーマや横断的な研究会活動を活発化するとともに、技術委員会および研究会の運営についても、支出内容の見直しを含め自立化かつ健全化を推進する。
- (4) 大会事業については、春季講演大会、秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム、国際会議ICEP、ワークショップを実施する。これらのイベントへの参加者および発表者の増加を図るため、新分野のセッション企画などを強化するとともに、収支改善のため運営の合理化を進める。さらに、各行事の将来の方向性、運営の充実を図るための仕組みづくりを考えていく。
- (5) 展示会事業については、JPCAShow/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーの4展示会の活性化と来客数の増加を図るため、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、及び、eX-techを実施するなど内容を充実していく。また半導体関連分野の企業との連携を強化するため、セミコン・ジャパンにおいて学会活動紹介展示と実装技術セミナーの開催を行う。
- (6) 教育事業については、将来を担う実装技術者、若手技術者を育成するためにきわめて重要であり新たな取組みや充実した活動を目指していく。具体的には、教育講座2件、教育セミナー2件に加え、新たに若手会員のニーズに応えられるよう演習などを加えた教育講座を開催する。
- (7) 会誌発行事業は、学会活動のアウトプットとして重要であり、例年通り学会誌を7回、英文論文誌を1回発行するとともに、会員の利便性向上と会誌発行費用の削減を図るため、電子Web化をさらに推進するとともに、広告掲載料の増収にも努力する。学会誌への投稿は、JSTの電子投稿システムを本格運用する。英文論文誌は冊子印刷を止め電子閲覧のみとし、経費圧縮をするとともに、海外への情報発信を強化するため英文HPに掲載して公開する。
- (8) 国際事業については、国際会議ICEPを機軸に、IEEE CPMT、IMAPSとの国際交流活動を継続し、具体的な活動につなげる。ICEPの開催に関してIEEE CPMTおよびIMAPSとMOUの締結を更新し、具体的協力体制を構築していく。
- (9) 支部事業については、支部の主体性を尊重しつつ、活動を推進していく。関西支部は前年と同様に、若手研究者セミナー、技術講演会、関西ワークショップ、“ぶらっと関西”を開催するとともに、九州支部は自主イベントを開催し、地域活動の活性化を図る。関西支部10周年記念講演会は、海外からの招待講演も含めて企画する。また、東北・北海道地区の活動を強化し、支部化へ向けた準備を進める。
- (10) 表彰事業活動については、例年通り、学会活動の活性化を目的に、学会活動に功績のあった方および学術的・技術的に貢献があった方に学会各賞を贈呈する。

2. 学会運営体制

(1) 財務体質の安定化

永続的に学会が運営できる財務基盤の確立を目指し、費用の見直しと収益の改善に、より一層の努力をする。

(2) 会員数の増強

前年度に引き続き、会員数の増強に積極的に取り組む。平成 23 年度から導入したシニア会員制度および賛助会員向けの特典（クーポン券）の効果を評価するとともに、イベントの収支に与える影響についても調査する。

3. 大会事業活動（定款第 4 条第 1 号関係）

(1) 「国際会議 ICEP 2013」を 2013. 4. 10～12 に大阪国際会議場にて開催する。IEEE CPMT Japan および IMAPS と共催し、当学会の国際的プレゼンスを向上させ国際交流を推進する。

(2) 「第 23 回秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム」を 2013. 9. 12～13 に大阪大学 吹田キャンパスで開催する。実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新の研究・開発の成果発表と情報交換の場を提供する。活性化の施策として“ものづくりセッション”、大学研究室紹介コーナーを企画するとともに、収支改善に努める。

(3) 2013 ワークショップを 2013. 10. 17～18 にラフォーレ修善寺を開催する。注目されている実装技術について、発表者と参加者と双方向のディスカッションにより理解を深めるイベントとして提供する。活性化を図り参加者を増やすとともに収支改善に努める。

(4) 「第 28 回春季講演大会」を 2014. 3. 5～7 に拓殖大学で開催する。実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新技術開発の発表と情報交換の場を提供するとともに、ものづくり技術の紹介により企業からの参加の機会を増やすとともに、チュートリアル講義により若手研究者の参加者増も図り、活性化を図るとともに収益増に努める。

4. 展示会事業活動（定款第 4 条第 1 号関係）

(1) JPCASHOW/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーの 4 展示会(2013. 6. 5～7 東京ビッグサイト)の活性化と集客増員に寄与することを目的に、「最先端実装技術シンポジウム」、「アカデミックプラザ」及び「eX-tech」を実施する。また、これらのイベントをマイクロエレクトロニクスショーの中のイベントと整理して、位置づけを明確化するとともに個々の活性化と連携を深め効率的な運営を行う。

(2) 「セミコン・ジャパン 2013」(2013. 12. 4～6 幕張メッセ)に当学会の活動を紹介するブースの出展と実装技術セミナーの開催により、引き続き、半導体分野への会員拡大と連携を推進する。

5. 技術調査事業活動（定款第 4 条第 2 号関係）

(1) 技術委員会の活動

13 技術委員会を組織し、各実装技術分野について、技術動向の調査活動を推進する。それらの活動で得られた成果をもとに、技術展望などについては学会誌に掲載するとともに、大会行事や最先端実装技術シンポジウムなどへの支援も行う。

(2) 研究会の活動

新設、統合された「官能検査自動化研究会」、「先端実装・電子部品研究会」、「環境と実装研究会」を含め、23 研究会を組織し、具体的な個々の実装関連テーマについて調査活動を推進する。委員相互の情報交換や、必要に応じて試料作製から測定・評価を行い情報が共有できる場を提供する。引き続き、研究会運営の自立性と横断テーマなどの新規分野の研究会創設を目指す。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果については、公開研究会や学会誌などで広く公開する。

6. 教育事業活動（定款第4条第3号関係）

(1) 教育講座

実装分野の研究開発者の育成に寄与するため「実装技術入門講座-初級コース」（2013.6.27～28）と「実装技術総合講座」を継続する。

(2) 教育セミナー

例年どおり、教育的見地から、注目されている実装技術をテーマとした「定例セミナー」を2回開催する。

(3) 演習付き教育講座

演習付き教育講座として、伝熱解析に関するテーマで開催を計画する。演習時間を充実するなどカリキュラムを工夫して実施する。

7. 会誌発行事業活動（定款第4条第4号関係）

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

JSTの電子投稿システムを本格運用して、例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を7回発行する。研究開発活動の成果として研究論文、総合論文、速報論文、解説等を掲載し、実装技術に関する最新情報を会員に提供する。また、理事会や各事業委員会の活動状況についても広報する。

(2) 英文論文誌の発行

本学会の国際的な認知とプレゼンスの向上を図るため、引き続き、英文論文誌（Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.6）を発行する。費用圧縮のため、電子閲覧を基本とし、冊子は希望者に有料で配布とするように変更する。国際的なプレゼンス向上のため、英文HPで電子閲覧できるようにして、海外への情報発信を活性化する。

(3) 韓国語翻訳転載

学会誌の研究論文、解説論文の一部を韓国語の雑誌への翻訳・転載を継続する。当学会会員の国際的なプレゼンス向上と技術の国際普及に貢献する。

8. 国際事業活動（定款第4条第5号関係）

(1) IMAPS との連携

米国 IMAPS の年会に設けられている Japanese Session の企画への協力など、IMAPS 対応委員会を通じて連携した活動を継続する。本学会会員に、Affiliate 会員として IMAPS に入会できる便宜を図る事業も継続する。アジアの IMAPS 系地域組織との交流では、Asia Liaison Committee に役員を派遣し、コンファレンスの企画に参加するなどの活動を推進する。ICEP 開催については IEEE CPMT と同様に、IMAPS に共催を依頼する MOU を締結する。

(2) IEEE CPMT Society との連携

国際会議 ICEP2013 については、引き続き、IEEE CPMT Japan Chapter には共催いただくとともに、論文発表の勧誘や優秀な論文の表彰などを連携して実施する。IEEE CPMT Japan Chapter が主催するイベントと本学会の行事に相互に協賛するなど、本学会会員に国際交流活動の場を提供するとともに、当学会の国際的なプレゼンスを高める機会とする。

9. 支部事業活動（定款第4条第6号関係）

(1) 関西支部の活動計画

若手研究会セミナー（2013年6月と12月開催予定）、技術講演会（2014年2月開催予定）、関西ワークショップ（2013.7.18～19）、および見学会付き講演会の「ぷらっと関西」のイベントを、引き続き実施する。技術講演会については、関西支部10周年記念講演会として、海外からの招待講演も含めて企画する。関西ワークショップは前回同様、経験豊かな先輩を囲んでのナイトセッション

ョン等を企画し、参加者の増員を図る。

(2) 九州支部の活動計画

九州支部の独自イベントとして、技術講演会と若手研究会セミナーを企画して支部会員の情報交流の場を提供するとともに、産業界・大学と連携する活動を行う。

(3) 東北・北海道地区の活動計画

東北・北海道地区の会員数増強の推進体制を構築して、地区の活動基盤を固めていく。

10. 表彰事業活動（定款第4条第6号関係）

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーションの向上のため、例年通り、エレクトロニクス実装に関する学術の発展および学会活動に対して功績のあった方に学会賞、功績賞、技術賞、論文賞、技術功労賞を贈呈する。技術功労賞の表彰対象を広げ、学会活動の活性化に役立てる。各種イベント（春季講演大会、秋季大会 MES、国際会議 ICEP）についても、例年通り優秀発表者を表彰する。

第4号議案

平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
(1) 継続(公益) 事業収入	46,490,000	44,250,000	2,240,000	
大会事業収入	23,500,000	24,200,000	△ 700,000	参加者数動向予想に基づく
展示会事業収入	60,000	80,000	△ 20,000	
技術調査事業収入	9,200,000	6,350,000	2,850,000	前年実績にもとづく
教育事業収入	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	
会誌発行事業収入	6,650,000	6,460,000	190,000	
国際事業収入	80,000	140,000	△ 60,000	
支部事業費	2,500,000	2,320,000	180,000	
(2) 法人会計収入	48,650,000	49,090,000	△ 440,000	
① 会費収入	48,600,000	49,040,000	△ 440,000	
入会金	240,000	200,000	40,000	
正会員会費	22,600,000	23,000,000	△ 400,000	会員数動向予想に基づく
賛助会員会費	25,520,000	25,600,000	△ 80,000	同上
学生会員会費	240,000	240,000	0	
③ 雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	95,140,000	93,340,000	1,800,000	
2. 事業活動支出				
(1) 継続(公益) 事業費支出	76,760,000	79,000,000	△ 2,240,000	
大会事業費	14,700,000	15,180,000	△ 480,000	参加者数動向予想に基づく
展示会事業費	850,000	720,000	130,000	
技術調査事業費	10,300,000	8,000,000	2,300,000	前年実績にもとづく
教育事業費	1,400,000	2,010,000	△ 610,000	前年実績にもとづく
会誌発行事業費	11,860,000	12,990,000	△ 1,130,000	英文論文誌の号子廃止等による削減
国際事業費	80,000	130,000	△ 50,000	
支部事業費	2,900,000	2,870,000	30,000	関西支部10周年記念行事費用含む
表彰事業費	1,090,000	1,080,000	10,000	
事業共通事務費	33,580,000	36,020,000	△ 2,440,000	注1
(2) 法人会計支出	21,380,000	23,170,000	△ 1,790,000	注1
事務人件費	10,400,000	11,000,000	△ 600,000	事務局職員若返りによる人件費の減少
福利厚生費	1,800,000	1,850,000	△ 50,000	
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0	
会議費	250,000	300,000	△ 50,000	
通信運搬費	600,000	650,000	△ 150,000	前年実績にもとづく
什器備品費	0	170,000	△ 170,000	前年実績にもとづく
消耗品費	400,000	450,000	△ 50,000	
印刷費	300,000	230,000	70,000	
光熱水道費	120,000	150,000	△ 30,000	
旅費交通費	700,000	850,000	△ 150,000	前年実績にもとづく
賃借料	3,200,000	3,170,000	30,000	
租税公課	390,000	770,000	△ 380,000	前年実績にもとづく
事務電子化経費	800,000	1,000,000	△ 200,000	機器更新はリースにより分散支出
諸謝金	670,000	680,000	△ 10,000	
新公益法人制度対策費	0	70,000	△ 70,000	一般社団法人に移行したので不要
雑費	350,000	330,000	20,000	
事業活動支出計	98,140,000	102,170,000	△ 4,030,000	
事業活動収支差額	△ 3,000,000	△ 8,830,000	5,830,000	
継続(公益) 事業当期収支計	△ 30,270,000	△ 34,750,000	4,480,000	
法人会計当期収支計	27,270,000	25,920,000	1,350,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入	0	17,100,000	△ 17,100,000	
② 学術振興特定資産取崩収入	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
③ 情報ネットワーク構築特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	3,000,000	26,100,000	△ 23,100,000	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産支出(再掲)	3,000,000	3,000,000	0	
② 退職金支出	0	17,100,000	△ 17,100,000	
投資活動支出計	3,000,000	20,100,000	△ 17,100,000	
投資活動収支差額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	170,000	△ 170,000	
前期繰越収支差額	21,938,727	25,691,775	△ 3,753,048	
次期繰越収支差額	21,938,727	25,861,775	△ 3,923,048	

固定資産の増減

	増額	減額(原価償却費)	増減額
固定資産合計	0	64,511	△ 64,511
器具備品	0	12,111	△ 12,111
ソフトウェア	0	52,400	△ 52,400

注1: 事業を行うための管理費用を分攤計上。管理業務と事業業務で職員の稼働時間で比例配分した人件費及び福利厚生費を配分。その位退職給

理事・監事候補者(案)

(アイウエオ順・敬称略)

[新任理事]

1. 阿部 治 日本大学
2. 池田 徹 鹿児島大学
3. 岡本 和也 大阪大学
4. 折井 靖光 日本アイビーエム株式会社
5. 齊藤 雅之 株式会社東芝
6. 須賀 唯知 東京大学
7. 杉原 興浩 東北大学
8. 土門 孝彰 TDK株式会社
9. 西田 一人 パナソニック株式会社
10. 羽深 等 横浜国立大学
11. 宝蔵寺 裕之 株式会社日立製作所
12. 益 一哉 東京工業大学

[新任監事]

1. 越地 耕二 東京理科大学
2. 若林 信一 財団法人長野県テクノ財団

[退任理事]

1. 嶋田 勇三 ナミックス株式会社
2. 浅井 博紀 株式会社東芝
3. 石樽 崇明 慶応義塾大学
4. 市川 公也 インテル株式会社
5. 井上 雅博 群馬大学
6. 大塚 邦顯 奥野製薬工業株式会社
7. 金谷 晴一 九州大学
8. 小岩 一郎 関東学院大学
9. 白石 洋一 群馬大学
10. 平 洋一 日本アイビーエム株式会社
11. 見山 克己 北海道工業大学
12. 柳浦 聡 三菱電機株式会社

[退任監事]

1. 中祖 昭士 大昌電子株式会社